

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成28年6月30日(2016.6.30)

【公開番号】特開2014-2376(P2014-2376A)

【公開日】平成26年1月9日(2014.1.9)

【年通号数】公開・登録公報2014-001

【出願番号】特願2013-109573(P2013-109573)

【国際特許分類】

G 0 3 G 15/20 (2006.01)

【F I】

G 0 3 G 15/20 5 3 0

【手続補正書】

【提出日】平成28年5月17日(2016.5.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

印刷に有用な装置であって、

第1の表面を有する第1の部材と、

前記第1の部材の前記第1の表面に接触する第1の部分を有するベルトと、

定着ニップを画定する領域において前記ベルトの第2の部分に接触する第2の表面を有する第2の部材と、

プロセス方向において前記定着ニップの下流に配置された剥離装置であって、1つまたは複数のトランスデューサセグメントのそれぞれを、前記ベルトの前記第1の部分の1つまたは複数の選択された区分を撓ませるための周波数で動かすように構成される1つまたは複数のトランスデューサを備え、前記ベルトに対する1つまたは複数の選択可能な剥離半径を、要求に応じて、前記プロセス方向の前記定着ニップの下流側における基材の前記ベルトからの剥離に関連づけられた剥離位置において生じさせる、剥離装置と、
を備える、装置。

【請求項2】

請求項1に記載の装置において、

前記1つまたは複数の選択可能な剥離半径が、少なくとも部分的には、前記1つまたは複数のトランスデューサの1つ以上を選択的に作動させることにより制御される、
装置。

【請求項3】

請求項1に記載の装置において、

前記1つまたは複数の選択可能な剥離半径の1つまたは複数の大きさが、前記1つまたは複数のトランスデューサによって生じる前記1つまたは複数のトランスデューサセグメントのそれぞれの動きのそれぞれの振幅に少なくとも部分的にもとづいてさらに制御される、
装置。

【請求項4】

請求項1に記載の装置において、

前記1つまたは複数の選択可能な剥離半径が、媒体タイプの判定にもとづき選択的に変更される、

装置。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、媒体サイズの判定にもとづき選択的に変更される、

装置。

【請求項 6】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、ベルト形状の判定にもとづき選択的に変更される、

装置。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、画像タイプの判定にもとづき選択的に変更される、

装置。

【請求項 8】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、媒体上の画像位置の判定にもとづき選択的に変更される、

装置。

【請求項 9】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、処理速度の判定にもとづき選択的に変更される、

装置。

【請求項 10】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、処理タイミングの判定にもとづき選択的に変更される、

装置。

【請求項 11】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数のトランスデューサが、前記 1 つまたは複数のトランスデューサセグメントが動く周波数に一致する周波数で前記ベルトを振動させ、前記ベルトからの前記基材の剥離を補助することができる、

装置。

【請求項 12】

請求項 1 に記載の装置において、

前記 1 つまたは複数のトランスデューサが超音波トランスデューサであり、前記 1 つまたは複数のトランスデューサセグメントのそれぞれを、超音波周波数で動かす、

装置。

【請求項 13】

印刷プロセスにおいて基材を剥離する方法であって、

印刷に有用な装置において定着ニップを画定するステップであって、前記装置が

第 1 の表面を有する第 1 の部材と、

前記第 1 の部材の前記第 1 の表面に接触する第 1 の部分を有するベルトと、

前記定着ニップにおいて前記ベルトの第 2 の部分に接触する第 2 の表面を有する第 2

の部材と、

プロセス方向において前記定着ニップの下流に配置された剥離装置であって、1 つま

たは複数のトランスデューサセグメントのそれぞれを、前記ベルトの前記第 1 の部分の 1 つまたは複数の選択された区分を撓ませるための周波数で動かすように構成される 1 つまたは複数のトランスデューサを備え、前記ベルトに対する 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径を、要求に応じて、前記プロセス方向の前記定着ニップの下流側における基材の前記ベルトからの剥離に関連づけられた剥離位置において生じさせる、剥離装置と、

を備える、定着ニップを画定するステップと、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径を、要求に応じて、少なくとも部分的に生じさせるステップと、

前記剥離位置における前記基材の前記ベルトからの剥離を少なくとも部分的に生じさせるステップと、

を含む方法。

【請求項 1 4】

請求項 1 3 に記載の方法であって、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径を、前記 1 つまたは複数のトランスデューサの 1 つ以上を選択的に作動させることにより少なくとも部分的に制御するステップをさらに含む、方法。

【請求項 1 5】

請求項 1 4 に記載の方法であって、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径の 1 つまたは複数の大きさを、前記 1 つまたは複数のトランスデューサによって生じる前記 1 つまたは複数のトランスデューサセグメントのそれぞれの動きのそれぞれの振幅に少なくとも部分的にもとづいてさらに制御するステップをさらに含む、方法。

【請求項 1 6】

請求項 1 3 に記載の方法において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、媒体タイプの判定にもとづき選択的に変更される、方法。

【請求項 1 7】

請求項 1 3 に記載の方法において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、媒体ジオメトリの判定にもとづき選択的に変更される、方法。

【請求項 1 8】

請求項 1 3 に記載の方法において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、ベルト形状の判定にもとづき選択的に変更される、方法。

【請求項 1 9】

請求項 1 3 に記載の方法において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、画像タイプの判定にもとづき選択的に変更される、方法。

【請求項 2 0】

請求項 1 3 に記載の方法において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、画像位置の判定にもとづき選択的に変更される、方法。

【請求項 2 1】

請求項 1 3 に記載の方法において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、処理速度の判定にもとづき選択的に変更される、方法。

【請求項 2 2】

請求項 1 3 に記載の方法において、

前記 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径が、処理タイミングの判定にもとづき選択的に変更される、方法。

【請求項 2 3】

請求項 1 3 に記載の方法において、
前記 1 つまたは複数のトランスデューサが、前記 1 つまたは複数のトランスデューサセグメントが動く周波数に一致する周波数で前記ベルトを振動させ、前記ベルトからの前記基材の剥離を補助できる、
方法。

【請求項 2 4】

請求項 1 3 に記載の方法において、
前記 1 つまたは複数のトランスデューサが超音波トランスデューサであり、前記 1 つまたは複数のトランスデューサセグメントのそれぞれを、超音波周波数で動かす、
方法。

【請求項 2 5】

プロセス方向の定着ニップの下流側の位置においてベルトから基材を剥離するように構成される、印刷に有用なシステムであって、

第 1 の表面を有する第 1 の部材と、
前記第 1 の部材の前記第 1 の表面に接触する第 1 の部分を有するベルトと、
定着ニップにおいて前記ベルトの第 2 の部分に接触する第 2 の表面を有する第 2 の部材と、

前記プロセス方向の前記定着ニップの下流に配置された剥離装置であって、1 つまたは複数のトランスデューサセグメントのそれぞれを、前記ベルトの前記第 1 の部分の 1 つまたは複数の選択された区分を撓ませるための周波数で動かすように構成される 1 つまたは複数のトランスデューサを備え、前記ベルトに対する 1 つまたは複数の選択可能な剥離半径を、要求に応じて、前記プロセス方向の前記定着ニップの下流側における前記基材の前記ベルトからの剥離に関連づけられた剥離位置において生じさせる、剥離装置と、
を備え、
前記基材が前記剥離位置において前記ベルトから剥離される、システム。